

点胶式液态导热垫片 XK-S20LV®

Thermal Conductivity Silicone Gel XK-S20LV

特性：

1:1混合 (流淌式)

1:1mix(no cure

by-product)

低应力应用

low stress applications

操作方便

Easy to Use

加热加速反应

Hear Fast Cure



应用：

汽车电子

Automotive electronic

S

通讯设施

Telecommunications

电脑及周边产品

Computer &

peripherals

导热，减震

Thermally conductive

vibration dampening

热源与散热器间应用

Between any

heat-generating

semiconductor and a heat

sink

	XK-S20LV	METHOD	UNIT
颜色 Color / Part A	Pink	Visual	
颜色 Color / Part B	White	Visual	
特征 Features	Soft GEL	-	-
密度 Density	2.8	ASTM D792	g/cm3

固化前性能 Before Cured Property

A:B	1:1	-	-
混合粘度 Mixed Viscosity (20rpm)	30,000	ASTM D2196	Cps
保质期 Shelf Life @ 25°C	6 month		

固化后性能 After Cured Property

颜色 Color	Pink	Visual	-
固化时间 Cure Schedule 1	24hr/25°C		
固化时间 Cure Schedule 2	100min/80°C		
固化时间 Cure Schedule 3	10min/100°C		
操作时间 Working time	30 min/25°C		
硬度 Hardness	Shore 00 = 65	ASTM D2240	
	AskerC = 28	JIS K7312	
抗张强度 Tensile Strength.	>0.2	ASTM D412	Mpa
伸长率 Elongation	100	ASTM D412	%
使用温度 Continuous Use Temp	-60~200		°C

电性能 Electrical Property

击穿电压 Dielectric strength	>10	ASTM D149	KV/mm
体积电阻 Volume resistivity	>10 ¹²	ASTM D257	Ohm-cm
介电常数 Dielectric Constant	7	ASTM D150	(1KHz)
阻燃性 Flame Rating	V-0	UL94	

热性能 Thermal Property

导热系数 Thermal Conductivity	2.0	ASTM D5470	W/m*K
热容 Heat Capacity	1	ASTM E1269	J/g-K